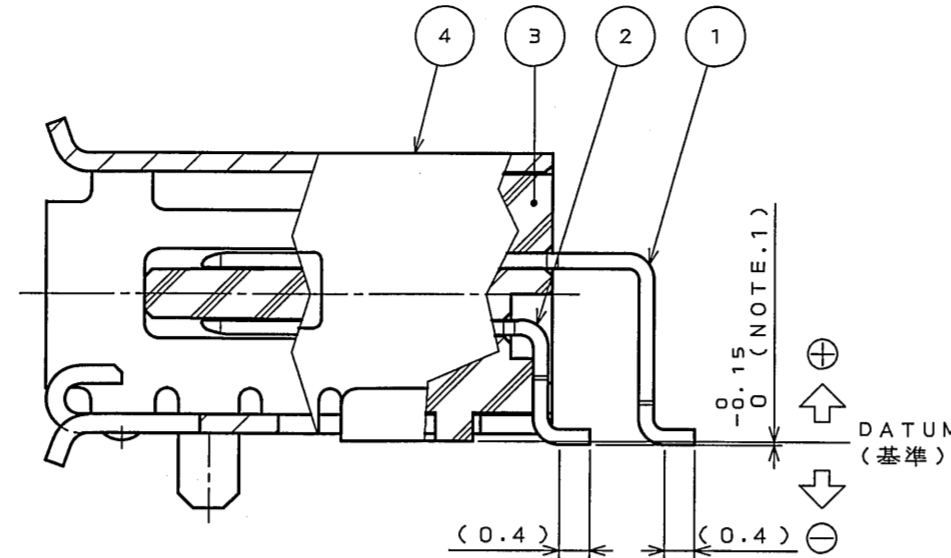
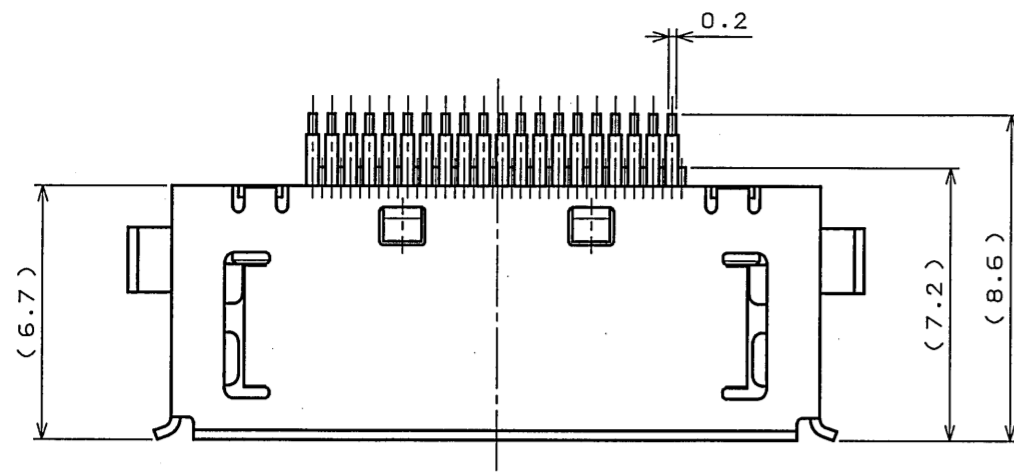
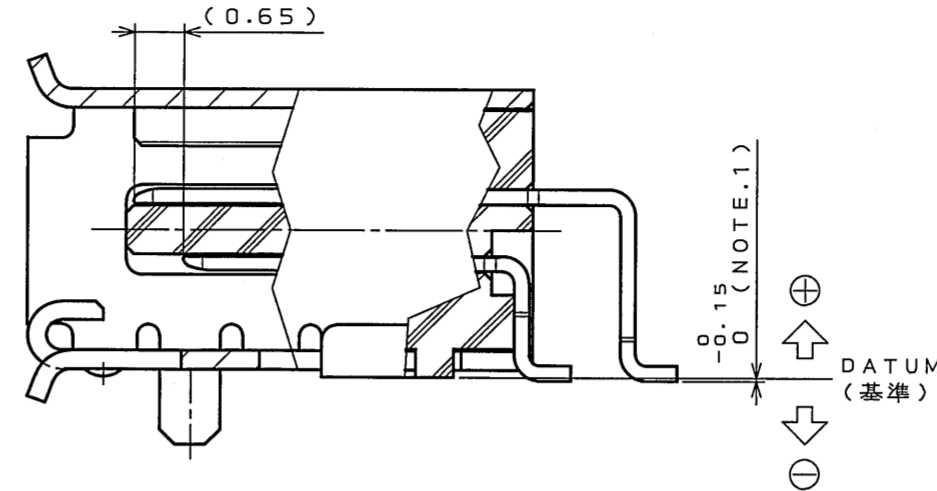


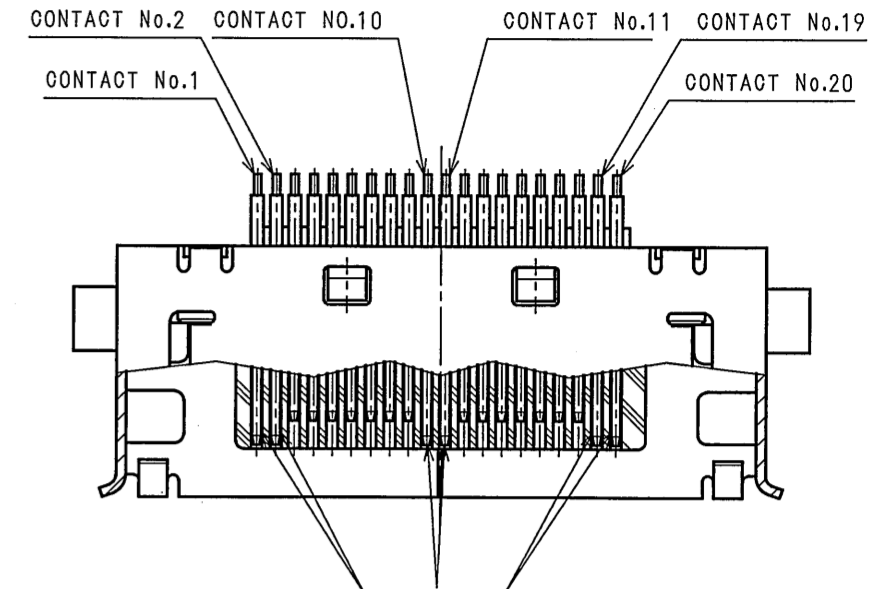
REV.	DATE	DCN NO.	DESCRIPTION	DR.	CHK.	APPD.	APPRO.
2	30.Jun.2004	055150	CORRECT AN ERROR		Y.SATOU		H. Amemiya



SECT. A-A (SCALE 10:1)

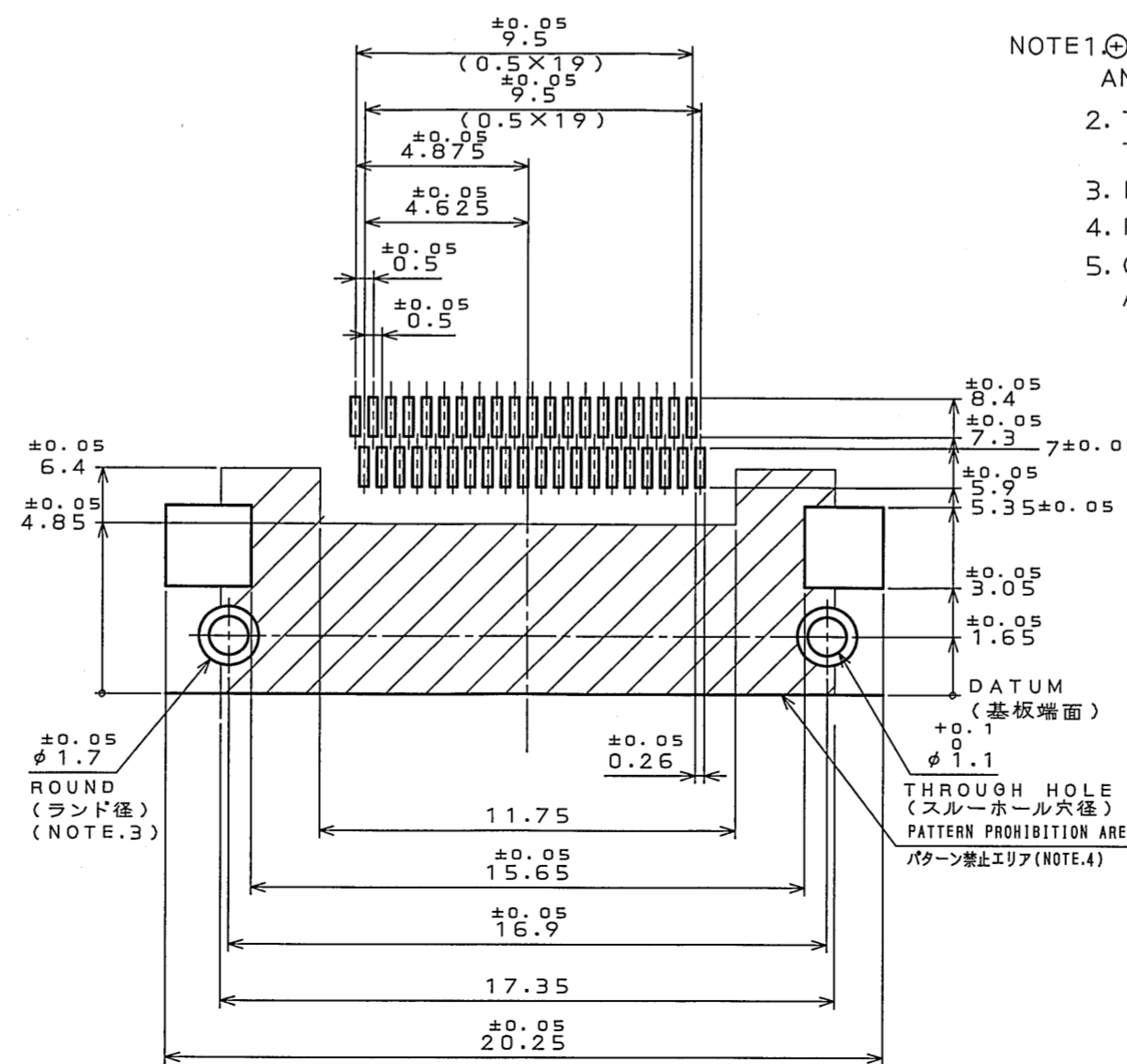
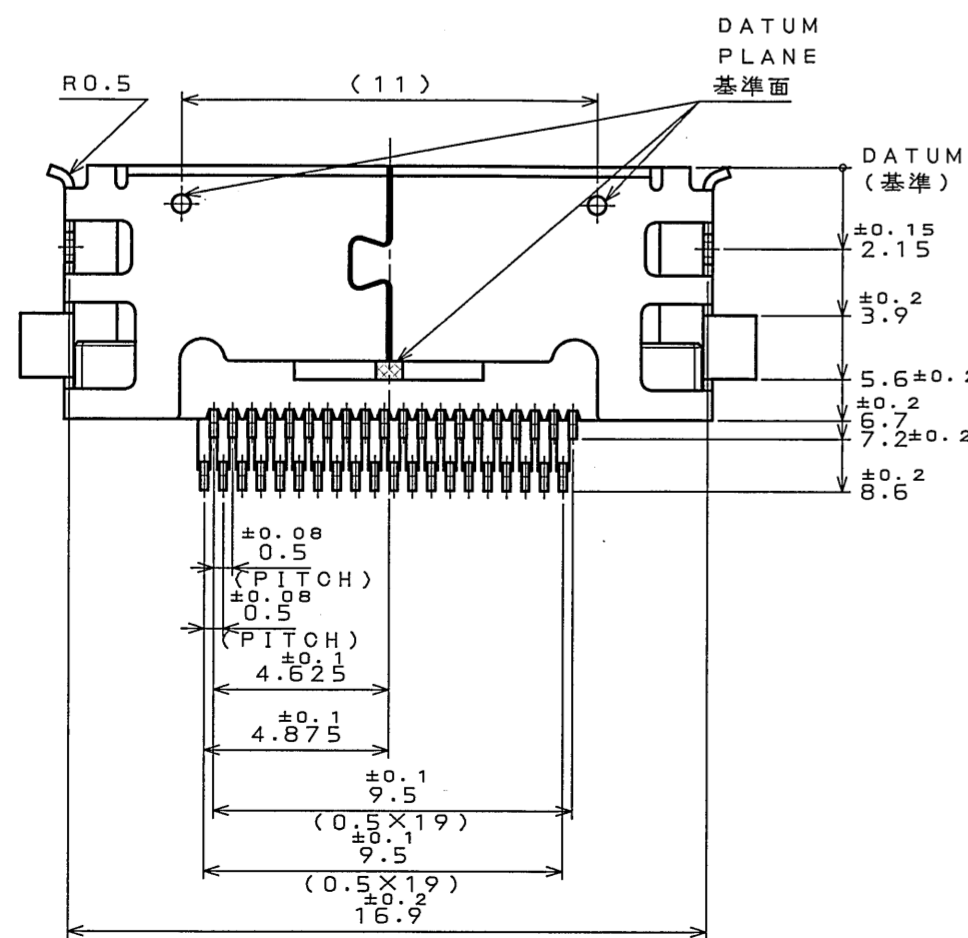
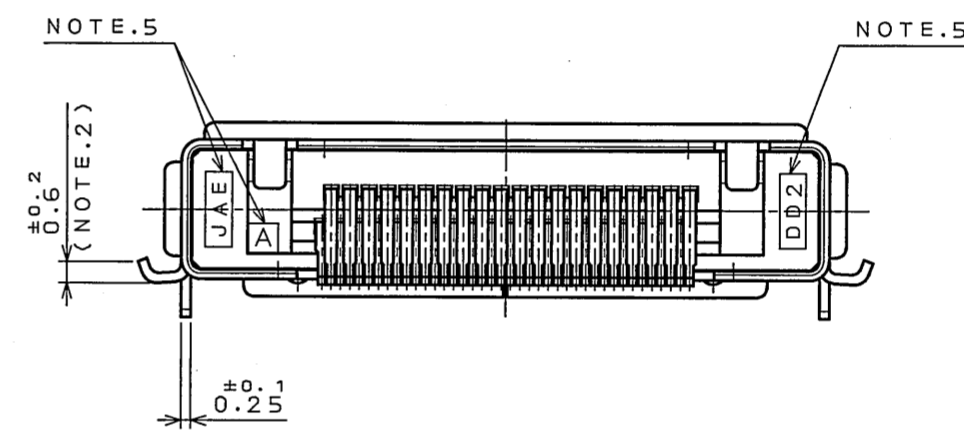
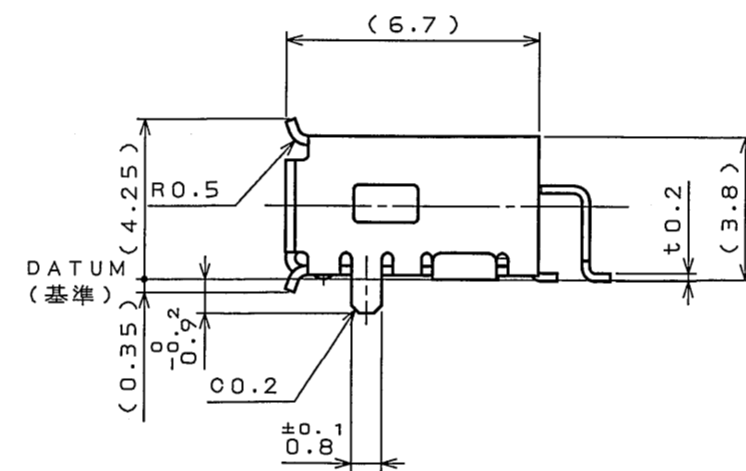
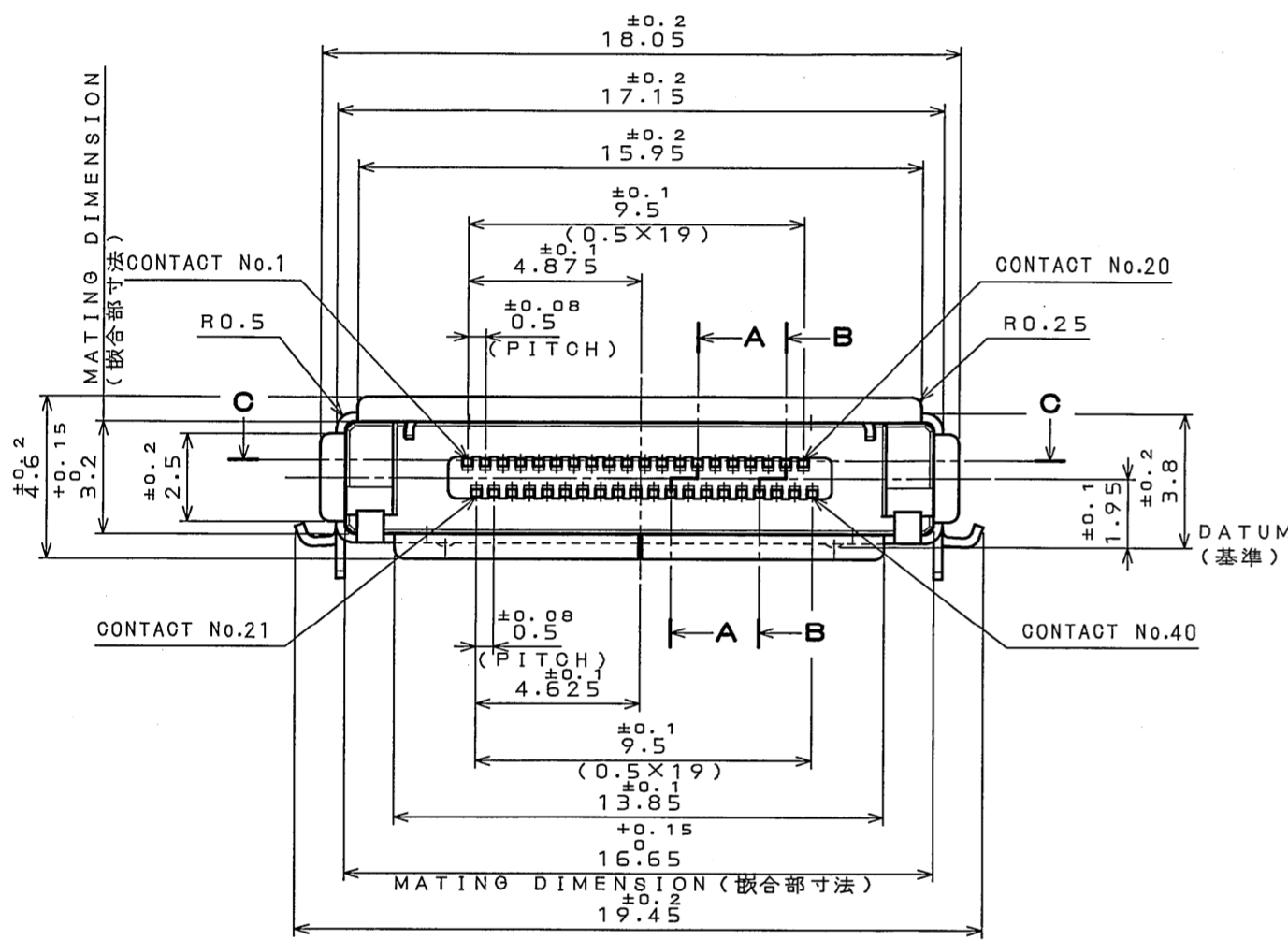


SECT. B-B (SCALE 10:1)



POWER CONTACT (電源用コンタクト)

SECT. C-C (SCALE 5:1)



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.) 適合基板寸法 (参考)

- NOTE 1 ⊕ AND ⊖ DENOTE ARE DIRECTION OF SMT TOLERANCE TERMINAL DIMENSION IS $0^{-0.15}$ AND DEVIATION (DIMENSION BETWEEN MINUS VALUE & PLUS VALUE) SHALL BE 0.1 MAX.
- THE HOLD-DOWN SHALL BE INSIDE THE INSULATOR JUDGING THE LOWEST CONTACT POSITION. THE COPLANARITY AMONG THE HOLD-DOWNS AND CONTACTS SHALL BE 0.1 MAX.
 - LAND MARK BOTH SIDES OF P.C.B. HOLE IS THROUGH HOLE PLATED.
 - PLEASE NO PATTERNING IN SLANT AREA.
 - COMPANY LOGO "JAE" AND CAVITY NUMBER "A OR B" AND PART NUMBER "DD2" ARE MARKED AS INDICATED.

- 注1. SMT公差部のプラス、マイナスの方向を示す。端子寸法は $0^{-0.15}$ であり、公差内におけるバラつき(1コネクタ内のMAX値とMIN値の差)は0.1以下とする。
- ホルドダウンは、コンタクトの基板側最下位置を基準にインシュレータ側にあるものとし、コンタクトを含めたバラつきは0.1以下とする。
 - ランドは基板の両側に設けること。また、スルーホールはスルーホールメッキであること。
 - 図に示す範囲(斜線部 コネクタ下部)をパターン禁止領域とする。
 - 図示の位置に社標 "JAE"、キャビ番号 "A又はB"及び品名 "DD2"を表示する。

NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
4	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING THROUGH HOLE AREA: TIN PLATING	
3	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	(BLACK)	UL94V-0
2	CONTACT 2	20	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD PLATING OVER NICKEL SMT AREA: TIN PLATING OVER NICKEL	CONTACT AREA Au: 0.1µm MIN.
1	CONTACT 1	20	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD PLATING OVER NICKEL SMT AREA: TIN PLATING OVER NICKEL	CONTACT AREA Au: 0.1µm MIN.

仕様書 (SPECIFICATION) JAOS-30011-1	第1版 (ORIGINAL DATE) 23.Feb.2004	尺 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) DD2	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
製造 DR.	担当 CHK. Y.SATOU	名称 (TITLE) DD2R040HP2		
検査 APPD.	承認 APPD. H.AMEMIYA	図面番号 (DRAWING NO.) SJ100279		

DOF-0-213E(03.08)

